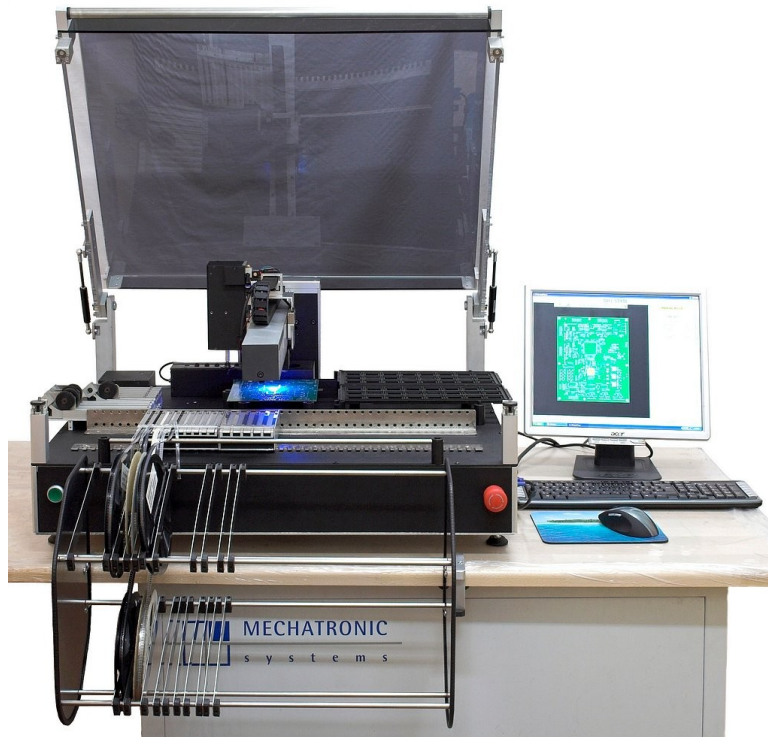


SMD Bestückungsautomat P30 mit Dispenskopf



- **PCB**
- max. Bestückungsbereich 400 x 500mm
- **Bauelementespektrum**
- von 0402 bis zum 25 x 25mm
- Pitch min. 0,4mm
- BGA , μ BGA, CSP, QFN
- **Bauelemente Verpackung**
- Gurte / Stangen / Trays
- **Bestückungsrate**
- bis zu 600 B/Std.
- **Dispensrate**
- bis zu 6000 dots/Std.
- **Zuführungen**
- max 80 x 8mm – Gurtfeeder (automatik+manuel) und
- 2 x (300 x 200mm) - IC-Tray bei der Leiterplattengröße:200 x 300mm
- **Auflösung**
- X / Y Achse – 0,008mm - Längenmeßsystem
- **Positionsgenauigkeit**
- +/- 0,03 mm
- **Abmessungen und Gewichte**
- 840 x 630 x 430 mm / ca. 85 kg
- **Versorgung**
- 230 V - 50 Hz - 350 W / 0,6 Mpa -15 l/min
- **automatischer Bestückungskopf**
- **automatischer Dispenskopf**
- **automatischer Pipettenwechsler**
- **Kamerasystem für automatische Referenzpunkt Korrektur**
- **Optische Bauelemente zentrierung**
- **Bildverarbeitungssoftware**
- **CAD – Editor für Gerber- und Bestückungsfiles**
- **Elektronischer Manipulator – Teach In**
- **intelligentes Feedersystem – CAN Bus**
- **Betriebssystem: Windows XP**
- **Bedienungsfeld: PC, Tastatur, Maus und 17" LCD monitor**
- **Anwendungsbereich**
- Bestückung von Standard SMD und Finepitch-Komponenten